

Ver.3.1S (2019.09)

Beam Profiler BPF-Sシリーズ

ビームプロファイラ取扱説明書

目次

1.	はじめ	に	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	3,	~4
2.	装置の	特	長	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		5
3.	装置外	·観	义	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		6
4.	使用上	の	注	意	•	•	•	•	•	•	•	•	•	7	~10
5.	装置使	用	方	法	•	•	•	•	•	•	•	•	•	11	~30
6.	よくあ	3	質	問	と		答	•	•	•	•	•	•	31	~35
7.	装置仕	様	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		36
8.	保証・	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•		37

段ボール箱開封時のご確認

- 段ボール箱に運送時の損傷がないかご確認ください。著しい損傷がある場合には直ちに運送業者にご連絡ください。
- 段ボール箱を慎重に開封し、すべての付属品(同梱の納入品ー 覧用紙)をご確認ください。
- 装置の外観に損傷がないか慎重に確認してからご使用ください。
 運送以外の原因で損傷があるとき、あるいは付属部品が欠品している場合には装置を使用せず、本書最後の頁にある連絡先へご連絡ください。
- 段ボール箱は輸送時保護のための一時的なもので、長期保管に は使用できません。
- ・開封以降、長期間本装置を使用されない間は、本装置光学部品 にカビが生えたり、結露するのを防ぐため、湿度管理された低 湿デシケータ内に保管していただくようにお願いいたします。

納入品(形態):ビームプロファイラ本体(1p)、USBケーブル(1p)、 トリガーケーブル(1p)、ソフトインストール用USBメモリ(1p)、 USBドングル(1p)* (RayCi-Standard、RayCi-Professional versionのみ)

1. はじめに

- 本取扱説明書に記載されている事項は、装置を安全に正し くお使いいただき、操作者他の負傷を防ぐためにあります。
 禁止事項、警告事項を必ずお読みいただき、主要な制限を 十分にご確認ください。
- 誤った使い方をしたときに生じる危害や損害の程度を区分して 説明しています。



【安全のために必ず守ること】

事故や故障のおそれがありますので、装置の分解、修理、 および改造を禁止します。これらの操作が認められた場合、 製品保証は失効し、必要な修理はすべて有償修理となりま す。また、修理をお断りする場合があります。これに由来 する直接的、及び間接的損害について、弊社は責任を負い ません。 装置を誤って落下させたり、強い衝撃が加えられたりして、 装置が正しく動作しないとき、特に異常な発熱や臭い、煙 が装置から発生したときには、ただちに使用を中止して弊 社へご連絡ください。また、装置を分解しないでください。 上記をお守りいただけない場合、いかなる結果についても 弊社は責任を負いません。



2. 装置の特徴

- 本装置は特殊な透明蛍光板を用いた世界で初めての ビームプロファイラです。 (特許取得/出願済)
- 本装置に取り付けられている蛍光板が測定面となります。レーザビームの測定したい位置に蛍光板を置くことで、その位置での高精度な2Dビームプロファイルをリアルタイムに測定できます。
- レーザ光はCW、パルス動作関係なく測定できます。
 低周波のパルス光の場合、トリガー信号を入力すれば、
 同期して安定した測定が可能です。
- ・ 蛍光板の損傷閾値は非常に高い^{※1}ので、フィルター 等でレーザ光を減光する必要はありません。光ファイ バー出射端、LD発光面、集光レンズに蛍光板を近づ けてプロファイルを測定できます。(波長によっては、 強く集光した場合、信号が飽和することがありま す。)
 - ※1 36頁の装置仕様参照

3. 装置外観



ご注意:外観寸法はBPF-Sシリーズ共通です。(本体の色、デザインはBPF-S400の例です) 性能改善のため、外観形状、端子位置は予告なく変更する場合があります。

4. 使用上の注意

	 <u>本装置の使用時には必ず、お使いになるレーザ波長に</u> <u>合ったレーザゴーグルを着用してください。反射光や散</u> <u>乱光により視力低下、失明するおそれがあります。</u> 	
取扱警告	 本装置に入射したレーザ光は、入射出力を維持したまま レーザ排出口を通して装置外部へ排出されます。そのため 排出されるレーザ光により、視力低下や失明、火傷や火災 が発生するおそれがありますので、予め入射出力に応じた 安全装置(ビームダンパー、ビームトラップ等)を排出口 側に設置していただき、排出されるレーザ光に対し十分に 安全な処理がなされた環境でお使い下さい。 	

 ・本装置の装置ので、 装置ので、 るので、 るので、 参考にこ ・本体表で、 <u>レーザ</u> ・本体表で、 本体表で、 本体表で、 本体表で、 本体表で、 ろので、 を考にこ ・ 	へ著しく高出 表面温度が上 を正のた を止め、 を止め、 度 上昇は で がれば 測	力なレーザ光 がることがあ 部の部品が破 された「温度 の異常な上昇 を中断してく 使用条件によ	たを入射し続い ります。本体 対したです。 なしたがなった時に たさい。 たさい。	†るとき、本 本の表面温度 るおそれがあ タの見方」を ま直ちに入射 す。下表を参					
)	1 13 10165 1.	海結測ウ	。)。 ———————————————————————————————————						
		建杭测正	时间(*1)						
	0~20min	20~40min	40~60min	60~360min					
本体の表面温度	30℃以下	30∼32°C	32 ~ 33°C	33 ~ 34°C					
* 1 测	*1 測定条件:LD出力 30W CW @808nm(BPF-S800) 環境温度26℃								
≪温度インジケータの見方≫ 温度インジケータは <u>40℃</u> で変色します。									
使用可(変色前) 使用中止(変色後) ※ 温度インジケータは水銀化合物を含有しております。 廃棄の際は、都道府県知事の許可を受けた専門の産業廃棄物業者に 委託してください。									

	表に従って、 −ザ光を入身 がり、装置る	<u>放射角(</u> 付しないでく を異常に加索	≧角、1/e ²) <u>【ださい。</u> レ ぬするおそれ	<u>が制限値を</u> ~ーザ光が装 ぃがあります	<u>超える</u> 置内部で 。
重要事項	レーサ	「光集光位	置と蛍光板	との距離	(mm)
	0	1	2	3	4
放射角制限值	38°	36°	36°	34°	34°
	50	50	50	54	54





重要事項

- レーザ入射面には、蛍光板を塵埃から保護するシールド 部品が搭載されております。
- この部品にはレーザ光に対して透明なARコート付きガ ラス(シールドガラス)が装着されております。
- シールドガラスを交換したり、レーザ出射端を蛍光板に 近接させて測定する場合に、取り外すことができます。
- この部品は六角穴付M2.5ボルト2個で蛍光板カバーに固定されております。取り外しは本器を固定した状態で行い、蛍光板面に対して垂直に持ち上げてください。
- 取り外し、取り付けの際は、蛍光板を傷つけないよう慎重に行ってください。





- ・ 蛍光板面は、□5mmのアパーチャが空いている上面の 蛍光板カバーから、正確に3.0mm奥にあります(蛍光板 カバーの厚みが3.0mm)。
- □5mmのアパーチャー周囲には、蛍光板カバー上面より深さ2.0mm、□10mmのザグリがあります。

重要事項

- 測定の際、蛍光板カバーが邪魔になる場合、あるいは蛍 光板に汚れがあり蛍光板カバーが邪魔でうまくクリーニ ングできない場合には、蛍光板カバーの二か所の六角穴 M2ネジを外し、カバーを取り外すことで、蛍光板を最 前面に完全に露出させることができます。
 - ・ <u>蛍光板カバーを取り外す際には、蛍光板面に対し垂直に</u> 持ち上げるようにしてください。
 - 横にずらして外すとカバーと蛍光板面が擦れ、表面の コーティングに傷が入るおそれがあります。
 - カバーを取り付ける際にも同じように十分注意してください。



5. 装置使用方法

- 2.【測定開始】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
 16
 レーザ光源を本器へ入射する手順です。

≪測定中の画面説明≫

- 2.1 【2D-Viewウィンドウ】・・・・・・・・・・・・・17~19 入射した光源の2D(2次元)強度分布を表示するウィンドウです。
- - — 2.3 【Beam Resultウィンドウ】
 ・・・・・・・・・・22~23

 入射した光源の2D強度分布から計算されたビーム径
 等を数値を表示するウィンドウです。
- 3.【データ保存】・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・29~30

測定データ保存の手順を説明しています。



次頁へ進み、手順をよく読んで正しくお使いください。

ソフトのバージョンによっては画面やメニューが異なる場合があります。 本取扱説明書ではRayCi-Lite Ver2.4.13をベースにしています。

1.【 測定準備】

- 1. ビームプロファイラ本体とPCを専用のUSBケーブルで接続してください。
- 2. デスクトップ上のアイコン「**RayCi64 Lite**」をダブルクリックします。



3. 「**Live Mode**」をクリックします。



Live Mode: Options」ウィンドウ内の「Wavelength」に、
 レーザの波長 [nm] を入力します。



青いウィンドウに 「Waiting for data」 と表示された場合 は、カメラとの接 続が不良です。 ケーブルの接続を 確認してください。

*ビームプロファイラ解析ソフトRayCiはCINOGY社の登録商標です。

5. 本器にレーザ光が入射していないことを確認してください。

①「**Calibration**」タブをクリックし、<u>カメラ感度のゼロ点調整を行います。</u>

②「Start」をクリックしてください。ゼロ点調整は約1~2分で終わります。



⑥. ①ゼロ点調整の終了を知らせる「Message」ウィンドウを閉じます。
 ②「Live Mode: 2D-View」ウィンドウを最大化します。



7. ①メニューアイコンにある「Beam Profiler Dynamic」をクリックします。
 ②立ち上がったウィンドウを最適サイズにして画面上に出しておきます。



8. ①メニューアイコンにある「Cross Section」をクリックします。
 ②立ち上がったウィンドウを最適サイズにして画面上に出しておきます。

1		1	The second s
	-	**************************************	New York Control of Co
			Constitution for the set #41 minute the black
) L O	

9. ①メニューアイコンにある「Beam Result」をクリックします。
 ②立ち上がったウィンドウは、「Live Mode: Options」ウィンドウと
 隣り合わせに画面中央に置きます。

	2		5		1		1744764
.0	3.0	Personal Annue Romaer Plant Panto Panto Ball Ball	1	2		100 III	A second former from the former former former former from the former for
		tra 16 bart				_	

10. ①「Beam Width」タブをクリックします。
 ②「2nd Moments (ISO11146)」を選択します。



「11. 「Live Mode: Beam Result」ウィンドウは下図の位置へ表示させておきます。



「12. 以上で測定準備完了です。

各ウィンドウに表示される情報は以下の通りです。

① [Live Mode: Option]

各種設定を行うメインウィンドウです。画面上に必ず表示させておいてください。

2 [Live Mode: 2D-View]

入射したレーザ光のプロファイル画像(二次元強度分布)をリアルタイム表示します。

- **③** [Live Mode: Beam Profiler Dynamic]
 - ②で表示した入射レーザ光の(ピーク)強度を示します。レーザ光が強くなるほど バーが右に伸びます。横軸の単位(300ms-100µs)はカメラの露光時間(CMOS 撮像素子が光を取り込む時間)です。入射光強度により自動で調整されます。 バーが右端まで伸び赤くなったときは、ただちに入射レーザ光を弱めてください。
- 4 Live Mode: Cross Section

②で表示されたプロファイル中央の断面強度分布を表示します。

(5) [Live Mode: Beam Result]

②で表示されたプロファイルのビーム径測定値を表示します。

2.【 測定開始】

弱いレーザ光をビームプロファイラ本体前面の蛍光板(□5mm)へ入射させてください。
 ※入射するレーザが蛍光板のほぼ中央に当たっていることを

IRプレートやIRカメラなどで確認してください。

- 入射するレーザ光の光軸は蛍光板に対して垂直になるようにしてください。
 - ※ 斜めから入射させるとレーザ光により本体内部が異常に加熱され、光学部品が破損するおそれがあります。さらにレーザ光が蛍光板の外周に当ると急激に発熱し、蛍光板が破損することがあります。



- レーザ光強度を徐々に上げてください。画面上の測定結果表示を確認します。
 そのまま所望の強度まで上げてください。
 - ※「Beam Profiler Dynamic」ウィンドウのグラフ表示が赤くなったときは、 入射光を弱めてください。



3. 各測定結果の説明は次ページ以降を参照してください。



2D-Viewウィンドウ上下左右位置関係と蛍光板の面内位置関係は 下図の通りです。①~④の番号で示された方向にそれぞれ対応 しています。





2.1 [2D-View]

「Live Mode: 2D-View」は、入射したレーザ光の2Dプロファイル画像です。

【 1. ≪ビーム径の測定≫

メニューアイコンにある「AOI Adjustment」をクリックします。

入射光プロファイルをソフトウェアが自動で探し出して楕円または矩形の点線表示で 囲います。この点線表示内のプロファイルがビーム径解析の対象になります。





マウスポインタを点線表示に合わせて ドラッグしますと、点線表示の位置、 形状を自由に変更できます。変更され た任意の領域が「AOI adjustment」 の対象範囲になります。 複数光源から成る入射光プロファイル から、任意の光源を選択したい場合な どに便利です。

 2. 《「AOI Adjustment」の設定選択≫ ウィンドウ内で右クリックすると現れるメニューから「Setting」を選択します。



Position by Peak

ビーム強度が最も強い位置(ピーク)を中心とする任意形状の楕円または矩形で プロファイルを囲みます。

Position by Centroid

ビームの強度重心を中心とする任意形状の楕円または矩形でプロファイルを囲みます。 ・Pos&Shape by 2nd Moments(デフォルト)

国際標準規格で定義されるビーム径を基準とする楕円または矩形でプロファイルを 囲みます。

Pos&Shape by BeamWidth

「BeamWidth」で規定されるビーム径を基準とする楕円または矩形でプロファイルを 囲みます。

▼ 3. 《「AOI Adjustment」のキャンセル≫

「AOI Adjustment」を再度クリックするとAOI Adjustment」の自動追尾がキャンセルされ、 アイコンの背景色が元に戻ります。さらに下段の「Reset AOI」をクリックすると形状も初 期状態(最大化)になります。





下図のように「AOI Adjustment」によって点線表示は出ているのに、ソフトウェア がプロファイルを見失っている等、正しくプロファイルを捕捉していないときには、 「Reset AOI」をクリックしてください。最大化の後、再度自動追尾します。 または前頁のように、マウスポインタを点線表示に合わせてドラッグし、手動で範 囲指定することも可能です。



*ソフトのバージョンによっては「Reset AOI」をクリックすると、AOIの形状が初期 状態にもどり、自動追尾もキャンセルされる場合があります。その場合には再度「AOI Adjustment」をクリックしてください。

2.2 [Cross Section]

「Live Mode: Cross Section」は、プロファイルの断面強度分布を表示します。

- 1. ≪プロファイル断面線の指定≫
 - ・メニューアイコン「Cross Section Adjustment」をクリックすると、
 「2D-View」ウィンドウに表示されているプロファイル上に断面線を自動で合わせま
 - ・メニューアイコン「X Cross Section」をクリックすると、
 プロファイルをX軸(横軸)に切り取った断面が表示されます。
 - ・メニューアイコン「Y Cross Section」をクリックすると、

プロファイルをY軸(縦軸)に切り取った断面が表示されます。



「2D-View」ウィンドウに現れる断面 線にマウスポインタを合わせてドラッ グしますと、断面線の位置を自由に変 更できます。変更された任意の位置が 断面強度表示の対象になります。 複数光源を含む入射光プロファイルか ら、任意の光源を選択したい場合など に便利です。

2. ≪プロファイル断面線の表示基準選択≫





ビームの強度重心を通る断面線で断面強度が表示されます。

※ X Cross Section、Y Cross Section、共に適用されます。

- ≪横軸の表示変更≫
 - ・拡大したい領域をウィンドウ内でマウスポインタをドラッグして指定すると、 指定した領域の背景色が変わります。



・マウスポインタのドラッグをし終えると、指定した横軸領域を拡大して表示します。
 これを繰り返すと、さらに拡大して表示します。※縦軸はここでは変更されません。



・細く表示された断面強度分布を拡大して見たいとき等に便利です。

- 4. 《縦軸の表示変更》
 - ・ウィンドウ内で右クリックすると現れるメニューから「Setting」を選択します。

ous Section			
Grid Lines			
Abscissa (X)		Clove	rueter (V)
Range			
 Full Range Data Range User define 	from	10	
Coordinates (St	405)		
W	11 (1) pr		0 2
Adjustment			
- Artivete	Position	by Peak	~

- ・Full Range 自動設定されたレンジ(露光時間)における 強度を表示します。
- Date Range
 測定データ内の最大強度(ピーク)で規格化
 した強度分布を表示します。
- ・User Defined Full Rangeの縦軸を任意に設定できます。

2.3 [Beam Results]

「Live Mode: Beam Results」は、ビーム径等解析結果の数値を表示します。 1. ≪ビーム径の表示(解析定義:2nd Moments[ISO11146]) ≫





・Width X 2D表示の横軸方向断面のビーム径(直径)[mm]です。

• Width Y

2D表示の縦軸方向断面のビーム径(直径)[mm]です。

Width Major

楕円ビームの長軸断面のビーム径(直径)[mm]です。

Width Minor
 楕円ビームの短軸断面のビーム径(直径)[mm]です。

2. ≪ビーム解析の定義≫

「Live Mode: Options」ウィンドウの中の「Beam Width」タブをクリックします。 「2D Method」欄内にある項目を選択して、ビーム解析の定義を指定します。 指定した定義に関連したメニューが、「Setting」欄内で選択できるようになります。



《「2D Method」で選択できるビーム解析の定義について》

24頁以降に各定義の詳細な説明があります。

「★」の表示がある項目は、RayCi-Standard、RayCi-Professinal versionで解析可能です。

o None(デフォルト)

ビーム径を計算しません。

• Threshold

光強度の閾値を決めて、ビーム内でその光強度を超えている領域の面積や全光強度を計算 します。

o 2nd Moments (ISO11146)

ビームの重心位置からの光強度の分布(2次モーメント)を計算し、その標準偏差をビーム径とします。プルダウンメニューのデフォルト値「2s」では、D4σ(ディーフォーシグマ)と呼ばれる、国際標準規格に従うビーム径を計算します。

• Fit Gauss

測定したビームプロファイルをガウス分布で近似し、近似曲線をもとにビーム径を計算し ます。

◦ Fit Super Gauss ★

測定したビームプロファイルをスーパーガウス分布で近似し、近似曲線をもとにビーム径 を計算します。

o Plateau 🛛 🛨

測定したプロファイルを矩形近似して、ビーム径を定義します。

◦ Simple Geometry ★

2D強度プロファイルで、領域内の光強度が指定した割合になる楕円または長方形の最小 面積を計算します。

• Area(simple connected)

2D強度プロファイルで、領域内の光強度が指定した割合になる自由形状の最小面積を計算します。

• Knife Edge 90/10

古典的なナイフエッジを用いたビーム径測定法をシミュレーションしたものです。

Moving Slite 86/14 ★

スリットスキャンによるビーム径測定方法をシミュレーションしたものです。

≪2D Methodで指定するビーム解析定義について≫

[Threshold]

矩形形状(Flat-top)のビームプロファイルに適した解析方法です。

ユーザーが光強度の閾値を決めて、ビーム内でその光強度を超えている領域を解析し ます。ユーザーは閾値「Threshold Value」としてAOI内の最大光強度に対する割合 (%)を、プルダウンメニューで1/e²(13.5%)、1/e(36.8%)、10%、50%、 90%から指定します。

Beam Resultsに次の値を出力します。

- Effective Power: AOI内の閾値以上の領域の全光強度
- Power Ratio: AOI内の全光強度に対するEffective Powerの割合
- Effective Area: AOI内で閾値以上の領域の面積
- Mean Intensity: Effective PowerをEffective Areaで割った値です。平均光強度。
- Flatness: Mean Intensityを最大光強度で割った値です。
 理想的な矩形形状の場合、1に近づきます。
- Uniformity:光強度のばらつきの規格化標準偏差をMean Intensityで割った値です。
 理想的な矩形形状では0に近づきます。
- Edge Steepness: Threshold Valueの10%と90%での面積の差を、10%の面積で 割った値です。0に近いほど、プロファイルの立ち上がりが 急峻になります。

[2nd Moments (ISO 11146)]

2nd Momentsは重心に対する光強度分布の変化を表現する値です。

特に「Sigma Environment」のプルダウンで「2s」を選択(デフォルト)した値は D4 σ と呼ばれ、ビーム径の国際標準の定義(ISO11145、ISO11146)になります。 ビームプロファイルが完全なガウス分布である場合、D4 σ の直径 ±2 σ は、±1/e²と 一致します。 Beam size 4 σ = ±2 σ



ビームは2次元の分布を有するためビーム径も2次元の楕円となります。



Beam Resultsに次の値を出力します。

- Centroid X,Y:ビームの(光強度の)重心の座標
- Width Lab: (カメラ) 表示画面のx、y軸に沿ったビーム径
- Width Beam: 楕円ビームの長軸(Major axis)と短軸(Minor axis)に沿ったビーム径
- Azimuth Angle:ビームの長軸とx軸の成す角度
- Ellipticity:短軸のビーム径を長軸のビーム径で割った値。円では1に近づく。
- Eccentricity: 真円に対するズレを数学的定義で表現した値。離心率。真円で は0。
- Cross-Sect. Area: 楕円の面積
- Intensity: 楕円内の全光強度をAOI内の全光強度で割った値。

[Fit Gauss]

ビーム形状をガウス分布で近似し、そのプロファイルの解析結果を示します。 ビーム形状が理想的なガウス分布に近い場合に有効ですが、さらにプロファイル の裾に信号ではないノイズ成分が多い場合にも、正しいビーム径をD4 σで計算す る際に有効です。

Beam Resultsには、通常の解析値に加え次の値を出力します。

- GFI:フィッテングの良し悪しを示す指標。適合度。最高が1。
- Correlation: 実データとフィッング値の相関_o



【Super-Gaussian-Fit】★

指数(Exponent)をフリーフィッティングパラメータとした、一般化されたガ ウス分布で近似し、そのプロファイルの解析結果を示します。ビームが単峰だが Fit Gaussでは裾がうまく一致しない場合に有効です。 Beam Resultsには、Fit Gaussの解析値に加え次の値を出力します。

● Exponent:フィッテング指数。(*Fit Gaussでは常に2)

【Plateau】 ★

矩形近似。矩形の中と外で光強度の分布のばらつきが最小になるような矩形を 計算します。2次元的には楕円または長方形を指定します。



Beam Resultsには、通常の解析値に加え次の値を出力します。

- Uniformity:中央部の光強度の分布(ヒストグラム)の半値全幅(FWHM)を最大強度 で割った値です。(ISO13694)平坦度が上がるほど0に近づきます。この ときエッジの影響を無視するために、中央のビーム領域をより中心部分だ けに制限して計算します。制限の割合は「Diameter Fraction」のプルダウ ンで63.21%、86.47%、98.17%、98.89%から選択できます。
- Roughness:中心部分の光強度の平均値からのズレの最大値を、最大光強度で割った値 です。
- Top Hat Factor: Top Hatにどれだけ近いかを表す指標で、理想的なTop Hatの場合は 1になります。ちなみにガウス形状の場合、0.5になります。



★ RayCi-Standard、RayCi-Professinal versionで解析可能です。

[Simple Geometry] ★

2次元的に楕円または長方形の形状で、その領域の中の全光強度が、ユー ザーが指定した割合(63.21%、86.47%、98.17%、98.89%)になる、最小 の面積の形状を計算します。

[Area (simple connected)] \bigstar

Simple Geometryと異なり、2次元の形状を定義せず、ユーザーが指定した 光強度の割合(63.21%、86.47%、98.17%、98.89%)となる最小面積を計 算します。

[Knife Edge 90/10]

古典的なナイフエッジを用いたビーム径測定法をシミュレーションしたものです。レーザビームをナイフエッジで塞いでゆき、透過光強度が10%と90%になるナイフの移動距離をビーム径と定義します。ビームを切る方向は、 カメラのx、y方向と楕円の軸方向の2種類選択できます。

[Moving Slit 86/14] ★

スリットスキャンによるビーム径測定方法をシミュレーションしたもので す。スリットを透過する光強度が、その最大値の13.5%に下がる位置の距離を ビーム径と定義します。スリットを切る方向は、カメラのx、y方向と楕円の 軸方向の2種類選択できます。

★ RayCi-Standard、RayCi-Professinal versionで解析可能です。

3.【データの保存】

プロファイルデータを取得、保存するために、測定モードを立ち上げます。

 メニューアイコンにある「Single Mesurement」をクリックします。新しい「2D-View」ウィンドウが立ち上がり、「Live Mode Options」ウィンドウが「Single Measurement Options」ウィンドウに切り替わります。



 「Live Mode: 2D-View」を見ながら測定したいタイミングで「Single Measurement Options」の「Start」をクリックするとデータ取得を開始します。「Measurement Period」 で、取得時のデータの積算フレーム回数や時間を予め選択、設定できます。なお、Base line 補正(31頁参照)を行わない場合は、予め「Live Mode: 2D-View」ウィンドウで下のチェッ クを外してください。「Single Measurement: 2D-View」からは操作できません。



 データ取得が終わると、「Single Measurement: 2D-View」に取得した2Dデータ(静止画) が表示されます。データを消して取り直すときは再度「Start」をクリックしてください。
 「Clear」をクリックすると、まだ保存していないデータは消去されます。続けて新しいデー タを取得する場合は、再度「Single Measurement」のアイコンをクリックして、新しい「2
 D-View」ウィンドウを立ち上げてください。データの保存は後からまとめて出来ます。デー タを保存する時は、保存したい「2D-View」ウィンドウのメニューアイコン「Save Mesurement」をクリックします。



4. 保存場所を指定し、名前を付けて保存してください。

	*	58		******	-			
	-							
	31281							
	1							
	a.c.a.						D	
		211426	19.44			100	1	
- i		3112883	3mg/s (Amazon de 1 / 41)		- 90.85	6111	 	
	-	-	Contract cover		Lette Baser		 -	
				100	6 Major		-	



・保存形式はTIFF (.tif) ファイルです。

- ・保存データはRayCiソフトウェア(Lite、Standard、ProfessionalいずれでもOK)
 で読み出し、断面強度分布、ビーム径などの解析ができます。
- 5. 解析結果のデータ(2D画像、断面プロファイル、ビーム径数値など)も、それぞれのウィン ドウから同じように保存(BMP、JPG、CSV形式など)できます。

6. FAQ

- Q: 2D-View画面に現れる黄色い点線の領域、AOIとは何ですか。
 A: "Area of Interest"の略で、ソフトが様々なパラメータを解析する領域 を示しています。画面(測定面)には見たいレーザビーム以外にも、ノ イズ、迷光が同時に入射していることがあり、メインのレーザビームの 解析の際に障害になります。AOIをメインのレーザビームの周りに設定 することで、AOIの外側の領域は解析上無視されるので、メインのレー ザビームだけを正しく解析することができます。
- 2. Q: AOIの設定方法は。

A:「Live-Mode:2D-View」ウィンドウの左側のメニューから、「AOI Adjustment」をクリックすれば自動で設定されます。自動設定はリアル タイムで更新されるので、ビーム径が刻々変化した場合でも、自動で AOIの領域が変更されます。メインのレーザビームと迷光の距離が近く、 自動設定のままでは分離できない場合や、迷光側にAOIが設定される場 合などは、マニュアルでAOIを設定できます。マニュアルで行う場合、 マウスのカーソルをAOIの点線上に移動させ、ドラッグすれば自由に位 置や形状を変更できます。この場合にはAOIは自動で更新されません。

- Q:AOIをリセットしたい時は。
 A:AOIを自動設定にしたままで、一旦レーザ入射を止め、再度入射した場合などに最初のレーザビームの位置と大きく離れている場合に、ソフトがビームを見失うことがあります。その場合には:「Live-Mode:2D-View」ウィンドウの左下の「Reset AOI」をクリックするとAOIが一旦最大化して、正しくビームを補足することができます。
- 4. **Q**: \lceil Baseline Correction $\rfloor \geq la_{\circ}$

A:「Live-Mode:2D-View」あるいは「Single Measurement:2D-View」ウィ ンドウの下端にある「Baseline Correction」は、AOIと連動して、AOIの 外側の領域の信号を積分して、その信号強度を「Baseline」として全体 の信号から差し引くという機能です。測定領域全域にわたり一様にノイ ズが乗っている場合に有効な補正です。デフォルトでチェックが入り、 機能するようになっています。しかしながら、AOIの外側に強い迷光が ある場合、その信号まで積分して「Baseline」として差し引くために、 場合によっては信号がマイナスになる領域ができることがあります(次 頁参照)。その場合、ソフトは異常と判断し、「Background Calibration」をやり直すようにアラームウィンドウを出します。この場 合、原因は「Background Calibration」ではないので、やり直す必要はあ りません。 (続く)

信号強度がマイナス



Baseline correction on/off

特に本装置の場合、入射するレーザビームの径が3mm以上大きくなる と、上図左のように蛍光板側面での蛍光の内部散乱光が、強くカメラ で検出されることがあります。この状態で「Baseline」補正を行うと、 上図右のようにメインビームの周辺では信号がマイナスになり、正し くビーム径を計算することができません。このような現象が見られた 場合には「Baseline Correction」のチェックを外してください。

5. Q:「Background Calibration」の方法、頻度は。

A: ソフトを立ち上げた時点で、最初に行ってください。測定する環境 下でレーザ光のみを止めた状態で行ってください。本装置自体は中が暗 室になっているので、部屋を暗くする必要はありません。ソフトの概略 説明版にあるように、キャリブレーションの条件は、デフォルトの「8 Flames」、「All Exposure Times/Gain Values」を選定してください。本装 置はレーザ光の強度に応じて自動でカメラの露光時間、ゲインを選択し ます(手動も可能)ので、最初にすべての露光時間についてキャリブ レーションを行っておく必要があります。また8時間程度の測定であれ ば、最初のソフト立ち上げ時1回で十分です。なお、ソフトを一旦立ち 下げた場合には、再度キャリブレーションを行う必要があります。

G:入射レーザ光強度はどこで確認すればよいですか。
 A:入射レーザ光強度に対し蛍光信号強度はリニアですが、その変換効率はレーザの波長や蛍光板により大きく変化するために、信号強度から入射光強度を推定することは単純ではありません。ビームプロファイラソフトにはパワー表示するようなメニューもありますが、校正が必要です。別途パワーメータ等で測定していただくことをお勧めします。

7. Q:光パワーの表示を有効にするにはどうすればよいですか。 A:Live modeでCalibrationをした後、レーザ光を入れて所望の出力(予め 測定しておいた出力)にして、「2D-View」でBPでビームを確認します。 この状態で下図のように「Live mode: Options」ウィンドウの「Units」を 開き、「Manually」にチェックし、その下の「P」にその想定される出 力をW単位で入力してください。この例の場合は1mWを想定し、0.001 あるいは1E-3を入力しました。ソフトのビット処理の関係で、その値に 非常に近い違う値に変換されて表示されますが正常です。同時に数値を 表示する「Beam Results」に校正されたパワーが、単位と共に表示され ます。なおパワーは左の「2D-View」のAOI(白い点線)の領域内だけを 積分して計算していますので、AOIの形状を大きく変えたり、Calibration やBease line補正をON/OFFしたりすると、それだけで値が大きく変わる ので注意してください。なお、レーザ出力が非常に低い場合には、パ ワー校正がうまくできない(機能しない)場合があります。



8. Q:入射レーザのパワーを上げているのに、ビームプロファイルの強度が低下しました。
 A:蛍光板の吸収発光効率はレーザ光の波長に強く依存します。そのた

め半導体レーザ(LD)のように、パワーを上げると波長が変化するレー ザの場合、波長が変化したために蛍光板での吸収発光効率が低下し、信 号強度が逆に低下する場合があります。その場合でもビームプロファイ ル(形状)の測定に影響はありません。

- Q:測定できる入射レーザ光の最大パワーはどのくらいですか。
 A:レーザ光の波長やビーム径により最大パワーが大きく変わります。
 本装置の仕様である蛍光板でのパワー密度が400kW/cm²を超えない範囲で、ソフトの「Beam Profiler Dynamic」が赤く飽和しない範囲(CMOSカメラが飽和しない範囲)、また放熱器の温度が50℃を超えない(時間)範囲であれば、30W超でも測定は可能です。
- 10. Q:どのような定義のビーム径が測定できますか。
 A:Live Modeの場合、「Live-Mode Options」から、Single Measurementの場合、「Single Measurement: Options」から「BeamWidth」のタブから様々なビーム解析が選択できます。特に「2nd Moments (ISO 11146)」は国際的なビーム径の定義になります。重心を通る断面で定義されますが、ビームの外周まで信号を積分するために、正しい計算のためにはBackgroundやBase lineの補正、AOIの設定が非常に重要なります。また古典的なナイフエッジやムービングスリットによる測定結果を計算によりシミュレーションすることもできます。詳しくは24頁に説明があります。
- 11. Q:「Live Mode」にしましたが、「Waiting for data」と表示されます。 A:カメラが認識されていません。パソコンと装置本体がUSBケーブルで 接続されているか、USBコネクタがしっかり奥まで差し込まれているか 確認してください。接続を確認し一旦ソフトを再起動しても認識されな い場合には、インストール時にUSBドライバが正しくインストールされ ていない可能性があります。RayCiのインストールメニューからUSBドラ イバをインストールしてください。またRayCiソフトインストール時に、 使用する機器にRayCiのカメラCMOS 1202以外を指定すると、カメラが認 識されません。また他のUSBを使うソフトが同時に起動していた場合、 干渉によってビームプロファイラソフトの動作が遅くなったり、カメラ を認識できなかったりします。その場合、他のUSBを使うソフトは立ち 下げてください。
- 12.Q:パソコンがレジューム状態になると、解除後ソフトがフリーズする。 A:パソコンのレジューム機能はOFFにしておいてください。またフリー ズした場合は、ソフトを再度立ち上げ、キャリブレーションから始めて ください。バッテリーの消耗を考慮し、測定にノートパソコンをご使用 の場合はできるだけACアダプターに繋いでご使用ください。

13.Q:トリガーケーブルを繋いでパルスレーザ光を測定したいのですが、 プロファイル像が出ません。

A:トリガーケーブルにはTTL信号(0-5V)を入れてください。 「LiveMode: Options」の「Trigger」のタブで、「Trigger」のプルダウ ンメニューから「Trigger In」を選択します。次に「Control」のタブでは、 デフォルトで露光時間(Exposure Time)が100µs(*Auto)になっていま す。Autoのチェックを外し、露光時間をプルダウンメニューで450µs程 度までマニュアルで増やしてください。これはレーザ光が入射して蛍光 が十分発光するまで、時間がかかるためです。またトリガー信号からの 遅れ時間(Delay)も必要があれば増やしてください。お客様の駆動回路 系によりトリガー信号からレーザ光が発光するまで時間がかかっている 場合があります。なお、上記の設定変更の際、「LiveMode: Beam Profiler Dynamic」で蛍光信号が飽和していないことを確認してください。

- 14. Q:全エネルギーの90%の範囲のビーム径を表示させたいのですが。
 A:「BeamWidth」の「Method」の"Simple Geometry"または"Area"に、その機能があります。隣の"Power Fraction"のプルダウンメニューでエネルギーの比率を選択します。デフォルトでは63.21%、86.47%、98.17%、98.89%から選択になりますが、その欄に"90"と数字を手で打ち込むと"90%"と表示され、「Beam Results」のビーム径や2D、3D表示が表示されます。
- 15. Q:ビーム径の定義でFWHM表示にするための方法を教えてください。 A:ビームの断面が表示された「X (Y) Cross Section」のウィンドウで右 クリック「Cross Section」というウィンドウが出ます。そこで「Cursor I (II)」のタブを選択、そこで「1D Beam Width」でプルダウンメニュー の「50%-50% (FWHM)」を選択してください。断面の画面に赤い2本 の線が表示され、「Beam Results」のテキスト画面にFWHMのビーム径 の数値が表示されます。なお、「Options」ウィンドウの「BeamWidth」、 「Method I (II)」タブには「Threshold」で「Threshold Value」のプルダ ウンメニューから「50%」が選択できますが、選択しても「Beam Results」には、50%以上の面積が表示されるだけで、特定の方向の FWHMのビーム径は表示されません。そこでさらに、「Fit Gauss」ある いは「Fit Super-Gauss」を選択してやると2Dおよび断面の画面に赤い線 が表示され、「Beam Results」に近似曲線でのFWHMのビーム径が表示 されます。

7. 装置仕様

測定波長範囲*	380-550nm (S400)					
			750-900nm (S800)			
			900-980nm (S900)			
			1030-1070nm(S1000)			
測定面積	□5mm					
分解能(カメラピクセル [・]	サイジ	ズ)	5.3μm × 5.3μm			
最小測定ビーム直径**			53µm			
最大測定ビーム直径			4mm			
カメラフレームレート	Up to 20Hz					
シャッター	Global					
測定モード	CW、 pulsed					
外部トリガー			TTL			
信号の直線性誤差	<1	% (<	<120kW/cm ²) (S400)			
	<1	% (<	< 300W/cm ²) (\$800)			
	<1	% (<	<120kW/cm ²) (S900)			
	% (<	(<3kW/cm ²) (S1000)				
空間距離誤差	空間距離誤差 <19					
蛍光板の損傷閾値***	2MW/cm ² (S400)					
(CW)	<1	00kW/cm ² (S1000)				
インターフェース		USB	2.0			
ソフトウェア OS		Win	dows 7/8/10 (32/64bit)			

*蛍光板材料の特性により、この波長範囲でもレーザ出力によっては測定できない波長が存在します。

カメラのピクセルサイズから、もっと小さなビーム径も測定、表示できま すが、ビーム内に10ピクセル(測定点)以上あることを推奨しています。 *損傷閾値はレーザの波長や動作モード(CW/パルス、パルス幅)に大きく 依存します。

8. 保証について

保証期間:ご購入から1年間

上記に定める保証期間内に、万一当製品に故障が発生した場合は、下記の 通り無償修理または代品交換をさせていただきます。当社までお申し出く ださい。

- 1. 取扱説明書等に従った当社指定の使用条件のもとで、保証期間内に、 万一当製品に故障が発生した場合は、無償にて故障箇所の修理または 代品交換をさせていただきます。
- 2. 上記修理後または代品交換後の保証期間は、購入時に定めた保証期間 内とさせていただきます。
- 3. 上記保証期間を過ぎた装置の故障については、修理費用はお客様のご 負担(有償)となりますが、有償修理後の該当修理部品については新 たに1年間の保証期間(無償)を設けさせていただきます。
- 4. 上記の無償保証期間内においても次の場合は有償とさせていただきま す。
 - 使用上の誤り、または当社指定に基づかない修理や改造により故障あるいは損傷した場合。

 - ③ 火災、公害、暴動、通信障害等の発生および地震、雷、風水害その他の天災地変など外部の要因または、特異な使用環境(粉じん、静電気、水漏れ、結露、薬品使用等)により製品が故障または破損した場合。
 - ④ 当社指定以外の機器を接続、あるいはソフトウェアで駆動したことに より製品が故障または破損した場合。

「保証について」は、明示した保証期間および条件のもとで上記に記載の 保証内容をお約束するものです。従いまして、明示、黙示を問わず、その 他の一切の保証を行うものではありません。

お問い合わせ先

カナレ電気 株式会社

光デバイス開発部

045-470-5512

〒222-0033

神奈川県横浜市港北区新横浜2-4-1 日本生命新横浜ビル2F